

证券简称：深科达

股票代码：688328

上市地点：上海证券交易所

深圳市深科达智能装备股份有限公司

Shenzhen S-king Intelligent Equipment Co.,Ltd.

（深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋、B 栋第一至三层、

C 栋第一层、D 栋）



向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿）

二零二二年四月

一、本次募集资金的使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 36,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目	15,504.83	11,766.50
2	半导体先进封装测试设备研发及生产项目	12,521.87	8,925.59
3	平板显示器件自动化专用设备生产建设项目	25,807.94	5,307.91
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		63,834.64	36,000.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于本次拟使用募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金运用具体情况

（一）惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目

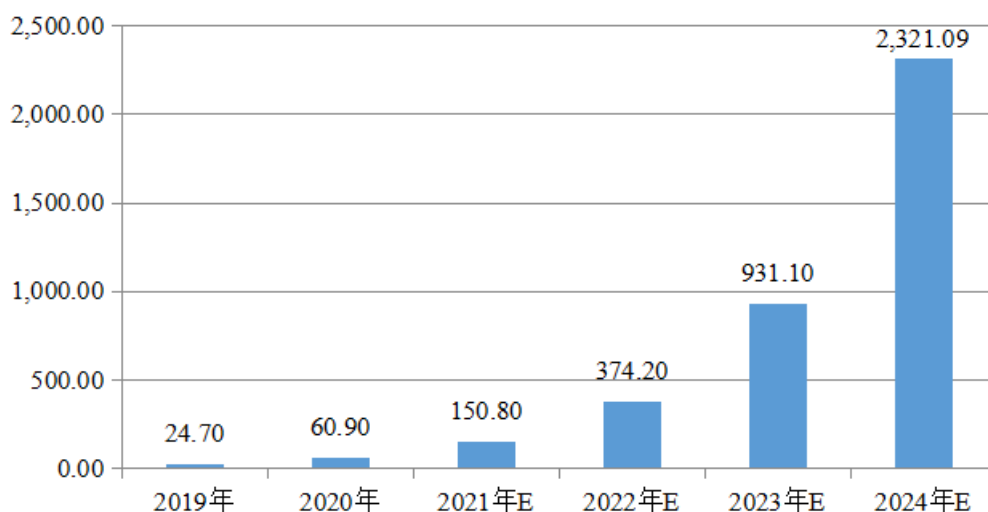
1、项目概况

本项目总投资 15,504.83 万元，建设期 2 年。本项目实施地为惠州市仲恺高新区建设，实施主体为惠州深科达智能装备有限公司。本项目通过建设生产与办公场地，购置先进生产设备及产线，用于新型平板显示智能装备生产，以扩大公司生产能力和产能规模，丰富产品结构，提高公司盈利能力，为公司未来业务发展提供可靠的扩产基础，进一步巩固公司行业地位，提高市场份额。

2、项目实施背景

随着平板显示技术的不断发展，Mini/Micro LED 背光作为新型平板显示技术已经引起了行业的广泛关注。Mini LED 以其高对比度、高亮度的优点对传统 LED 背光市场形成冲击，以媲美 OLED 的画质表现而成本更低的特点，赢得各大品牌青睐。2019 年开始，苹果、三星等终端厂商相继推出搭载 Mini LED 背光技术的高端产品，需求放量带动产业链同步繁荣。根据 LED inside 统计，2019 年国内 Mini/Micro LED 领域总规划投资额达 391 亿元，受疫情影响，2020 年投资速度有所放缓，总规划金额约 252 亿元，共计 24 个项目，涵盖设备、芯片、封装、面板、显示屏所有环节。随着商业化后技术进步及制程良率提升速度持续加快，Mini LED 应用场景将随着成本降低而不断加快渗透，行业进入高速发展期。同时，伴随着 Mini LED 的发展，将带动整个产业链迅速发展，其中就包括位于上游的生产专用设备行业。

2011-2022 年全球面板厂商设备投资规模趋势



资料来源：前瞻产业研究院

近年来，平板显示行业受益于下游智能手机、平板电脑等消费类电子产品带动，产业规模持续扩大，很多传统设备企业都纷纷涉足平板显示行业设备制造，近年平板显示设备行业市场竞争越来越激烈，低端设备市场价格越来越低，利润空间越来越少。因此，提高技术水平，向高端设备行业发展成为很多公司的选择。

本项目生产的产品主要为Mini/Micro LED精密组装及检测相关设备，该类设

备门槛较高。公司正是考虑到Mini/Micro LED等高端设备需求增加会推动其设备的需求量稳步提升，而且公司在业内品牌影响力较大，市场开拓能力较强，现有产能及库存无法匹配公司市场拓展的速度，在此背景下，公司有扩建厂房、扩大生产规模、提高新兴技术水平，向高端设备行业进军的基本诉求。

3、项目实施必要性

(1) 丰富公司产品结构，提高市场份额

随着技术的不断进步以及电子产品消费需求的不断变化，以LCD和OLED为代表的新一代显示技术已应用于智能手机、超高清电视等高端产品，并受到广大消费者的青睐。同时，大尺寸液晶电视、车载显示器、智能家居显示屏等电子终端产品的兴起，极大地带动了中大尺寸平板显示的市场需求。因此，为顺应市场发展趋势，公司先后研发设计了满足于OLED屏幕技术及中大尺寸显示领域的平板显示器件生产设备并成功销售。与 LCD 和 OLED 技术相比，Mini/Micro LED凭借着高分辨率、高色彩对比度、更快响应速度、寿命长和省电等优势被视为未来非常具有潜力的新型显示技术之一。

本项目旨在向Mini/Micro LED等新型高端显示设备进军，在现有平板显示设备产品基础上，先后对Mini LED和Micro LED精密组装检测设备进行研发生产，增加公司产品线，同时扩大公司的产品生产规模，提高产品供应能力，促进公司新产品的产业化生产，丰富公司产品种类，在优化产品结构的同时也增强公司规模效应。规模化生产可有效提高生产效率，缩短生产和交货周期，进而更好更快地响应市场客户的需求。此外，规模化生产在显著增强自身供货、竞争实力的同时，可以与下游智能手机、平板电脑等平板显示器件及零组件应用领域客户建立更好、更稳定的合作关系，建立并巩固良好的客户渠道，提高市场份额。

(2) 提高公司业务发展能力，扩大品牌影响力

公司目前紧跟市场与产业发展变化，着力于巩固现有的中小尺寸LCD与OLED生产规模与销售水平，并扩大OLED柔性贴合生产能力，增加大尺寸LCD生产能力与相关技术研发，同时旨在增加对Mini/Micro LED等技术的研发生产，立志于成为平板显示装备领域为客户提供最大价值的优秀企业。在装备领域，基于显示细分领域，在自动化装备行业上、下游不断延伸，使自身更具价值，不断

提升和优化自身的能力，成为社会尊重的企业。公司持续优化生产规模，建设惠州智能制造创新示范基地的过程就是公司扩展现有业务、提高公司业务发展能力的体现。公司持续提升制造能力，不断发展核心技术和工艺，致力于成为业界一流的智能装备制造公司。

本项目，公司拟在现有产品种类基础上，研发生产平板显示智能物流转运系统、平板显示IC支架组装机、全自动叠膜机等设备，向高端设备行业扩展，精准快速掌握下游客户的差异化需求，不断提高公司业务发展能力，进一步扩大公司产品影响力。

（3）把握行业发展时代机遇，奠定行业领先地位

近年来全球平板显示产业迅速发展，消费电子产品市场需求及消费热点不断变化，显示器件市场规模不断增加，加大了专用设备的更换速度。平板显示技术的不断更新及生产工艺的持续改进既要求平板显示组装、检测设备生产设备企业紧跟行业发展趋势、加大研发投入，也带动了平板显示器件生产设备市场需求。未来随着Mini/Micro LED等新型高端显示技术的快速普及与持续更新，平板显示器件生产设备行业将迎来新一轮的需求高峰。

公司有必要顺应行业技术发展趋势，坚持对行业新技术、新工艺、新产品的研究，保持自身在LCD、OLED平板显示器件自动化专用设备技术优势的同时，投入力量从事Mini LED、Micro LED等新兴平板显示领域的设备研制，不断推出满足市场需求的新产品，进一步增强公司的核心竞争力，奠定行业领先地位。

4、项目实施的可行性

（1）公司拥有较强的技术实力积累，为项目提供技术支持

平板显示器件生产设备行业是典型的技术密集型行业，技术集成难度高，产品开发难度大，公司长期专注于平板显示器件自动化专用设备研发和制造，技术优势突出。通过多年的持续努力，公司突破并掌握了精准对位、图像处理、运动控制、精密压合贴附等方面的核心技术，已具备提供涵盖OLED和LCD显示器件后段制程主要工序和工艺适用设备的能力，并拥有平板显示器件周边部件组装设备和检测设备的生产能力，能满足客户对于生产的特殊需求。公司在成本控制、产品质量、生产装配流程控制等方面的优势为公司产品顺利扩大产能、提高市场

占有率提供了坚实的技术支持。

（2）公司拥有完善的团队管理体系，为项目提供制度保障

公司拥有完备的内部管理制度，包括采购、生产、质检、销售等各个环节，采购方面，制定了采购管理制度、采购作业流程等；生产方面，有生产车间管理制度、制造中心安全管理制度、装配部组装作业流程等文件；质量检验方面，制定了来料检验作业指导、成品检验作业规范、产品的监视和测量管理程序等。

在研发方面，公司致力于依靠自主创新实现企业可持续发展，公司坚持以市场需求为导向的研发理念，注重技术的积累与创新，设立了多个事业中心或子公司负责承担具体的研发工作，构建了完善的研发体系，紧随平板显示产业发展趋势形成了富有竞争力的研发创新能力，研发实力一直居于国内同行业的前列。不仅如此，研发团队还密切跟踪及学习国际平板显示行业先进技术，及时把握下游行业发展动向，结合终端消费者的需求变化趋势，确立了一系列前瞻式研发项目，保证了公司在日益激烈的市场竞争中的技术研发优势。

（3）公司拥有广泛的客户群体和良好的品牌声誉，为项目提供市场基础

作为国内平板显示设备行业的优秀企业，公司在产品研发、生产、销售、管理等方面都积累了丰富的行业经验，公司始终坚持以客户需求为中心，以客户满意度为宗旨，凭借日益精进的研发水平、领先的生产技术工艺、完善的销售服务、卓越的产品质量，在平板显示领域积累了广泛而且稳定的客户群体。同时历经多年的积累，公司凭借不断增强的创新能力、安全可靠的产品质量和优质的客户服务，在行业内树立了良好的品牌形象。

目前，公司与天马微电子、华星光电、业成科技、华为、京东方、维信诺、友达光电、伯恩光学、蓝思科技、欧菲光等境内外行业龙头企业建立了良好的合作关系，同时参与了A公司Mini LED产品生产线构建项目，随着公司服务的深化和产品下游应用市场的拓宽，公司的客户群体将更加广泛，产品销售额也将会有较大幅度的提升，丰富的行业经验和广泛的客户群体为项目建设提供了扎实的市场基础。并且，公司凭借较强的技术实力、安全可靠的产品质量和优质的客户服务，在行业内树立了良好的品牌形象，在下游客户中获得了广泛的认可，从而降低了公司新客户、新产品的市场开拓难度，这也在一定程度上为项目的实施奠定

了基础。

5、项目实施主体与投资情况

本项目实施主体为公司全资子公司惠州深科达智能装备有限公司，项目建设地点位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村。本项目拟投资 15,504.83 万元，其中场地投资 5,318.14 万元，设备购置及安装投资 6,448.36 万元，预备费 738.33 万元，铺底流动资金 3,000.00 万元，具体情况如下：

序号	项目	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	场地投资	5,318.14	5,318.14
1.1	场地建设费	2,393.16	2,393.16
1.2	场地装修费	2,924.98	2,924.98
2	设备购置及安装投资	6,448.36	6,448.36
3	预备费	738.33	-
4	铺底流动资金	3,000.00	-
	合计	15,504.83	11,766.50

6、项目预计实施时间、整体进度安排

本项目建设期为 2 年，项目进度计划内容包括工程设计及准备工作、土建施工、设备购买及安装调试、新员工招聘培训、试生产及验收等。具体进度如下表所示：

项目实施内容	T1				T2			
	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12
工程设计及准备工作	■	■						
土建施工		■	■	■				
设备购买及安装调试					■	■	■	
新员工招聘培训							■	■
试生产及验收								■

7、项目经济效益分析

经测算，本项目税后的内部收益率为 18.17%，税后投资回收期为 6.42 年。

（二）半导体先进封装测试设备研发及生产项目

1、项目概况

本项目总投资 12,521.87 万元，建设期为 2 年。本项目实施地为惠州市仲恺高新

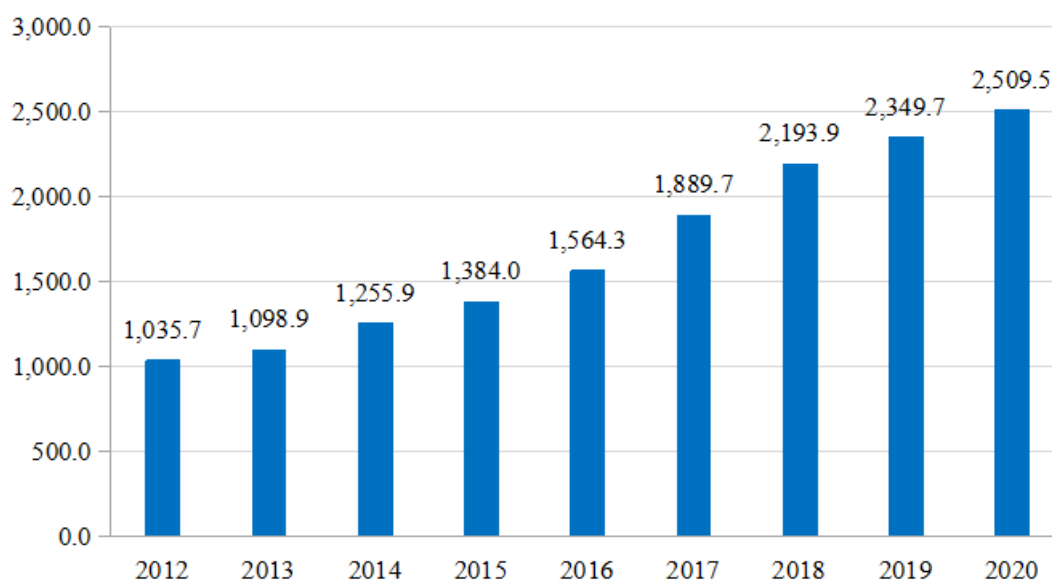
区建设，实施主体为惠州深科达智能装备有限公司。本项目拟通过建设生产与办公场地、购置先进的研发及生产设备，以满足公司半导体封装测试设备研发及生产所需。本项目是在公司现有半导体封测测试设备的基础上，研发新的产品线，拓展公司业务类别，项目将依托公司现有的技术及半导体领域的客户基础，扩大公司产能规模，持续提升研发创新能力，抓住行业快速发展的时代机遇，扩大公司盈利能力，提高市场竞争力。

2、项目实施背景

半导体行业主要包含电路设计、晶圆制造和封装测试三个部分，封装测试是半导体产业链的最后一个环节。半导体封测是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。我国半导体封测业是整个半导体产业中发展最早的，而且规模和技术上已经处于国际较高水平，半导体封测行业的快速发展，带动了我国半导体封测设备企业的发展。

纵观我国半导体封测领域的发展现状，总体上呈现出快速增长态势。根据中国半导体行业协会的统计数据显示，我国封装测试行业销售额从 2012 年的 1,035.70 亿元增长至 2019 年 2,349.70 亿元，复合增长率为 12.42%；2020 年销售额达到 2,509.50 亿元，同比增长 6.80%，封测行业正在加速进入国产化替代阶段。

2012-2020 年我国半导体封测行业销售额



数据来源：中国半导体行业协会

公司通过本项目建设实现产品向半导体领域应用拓展具有重要意义。首先，半导体产业面临国产化的时代机遇，公司紧跟市场与产业的发展变化，充分利用自身的资源优势与技术优势，向市场提供功能卓越的半导体封测设备，有利于下游制造企业优化并保障产品质量，提升其在全球市场的份额，加速半导体行业发展。其次，下游应用领域的拓宽，有利于公司实现产品的多元化布局，找到新的利润增长点，降低经营风险，从而实现可持续发展。

3、项目实施必要性

(1) 丰富公司半导体封装测试设备产品类别，满足客户需求

公司是一家智能装备制造制造商，在半导体封测业务领域，公司目前的主要产品为 IC 测试分选机等。近几年公司开拓了众多客户，半导体设备销量增长迅速，布局半导体设备领域初见成效。目前公司在半导体封装测试设备领域，产品较单一，无法满足下游客户多种设备需求。

本项目建设是在公司现有半导体封装测试设备基础上，研发新的半导体先进封装测试设备，丰富公司半导体封装测试设备产品类别，延伸产品线，进一步扩大公司业务范围，覆盖半导体封装测试更多环节，为客户提供更加多样化的产品选择方案，满足客户多样化需求，为公司培育新的利润增长点。

(2) 抓住市场发展机遇，提升公司市场竞争力

随着半导体封装测试市场规模不断增长，封装测试设备需求规模不断增加，半导体设备国产替代不断推进，为我国半导体行业提供了良好的发展机遇。本项目主要研发并生产半导体封装测试设备，属于国家产业政策鼓励和支持的项目。本项目实施是在有利的宏观政策环境下，抓住市场发展机遇，以封测设备为切入口，充分利用现有资源和能力，向市场提供多种先进的设备，提升公司市场竞争力的有力举措。同时，项目实施能有效提供公司技术研发能力，扩大公司生产规模，丰富产品线，提高本公司的竞争优势及盈利能力，从而提升公司市场地位。

(3) 提高技术研发能力，扩大产能规模，落实公司发展战略

公司定位于智能装备制造制造商，主要从事平板显示器件、半导体、摄像模组等行业生产设备的研发、生产、销售，并向智能装备关键零部件等领域进行了延伸。经过多年的发展，公司积累了丰厚的技术基础，拥有自主研发能力。公司始终坚

持掌握市场动向，打造核心技术竞争力的战略方针，依靠强有力的技术团队，为客户提供多样化的产品和服务。

4、项目实施的可行性

（1）公司拥有强大的技术研发实力，为项目建设提供技术支持

公司始终坚持以技术创新为核心竞争力，强调自主研发、自主创新，以技术进步驱动客户需求。半导体封装测试设备行业是典型的技术密集型行业，技术集成难度高，产品开发难度大，公司长期专注于智能化设备的研发及制造，现有设备虽然主要应用于平板显示行业，但本项目研发的半导体封测设备所采用的技术与现有技术具有较强的关联性。目前，公司已经掌握了半导体封测设备生产所需的精密视觉对位技术、图像识别技术、机器人与视觉融合技术、压力精密控制技术等技术。截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有已授权专利 286 项，软件著作权 39 项，有效注册商标 14 项，并已通过 ISO9001:2015 质量管理体系、信息化和工业化融合管理体系（GB/T23001-2017）等权威认证。

公司先后获得国家级高新技术企业、国家工信部两化融合认定、国家工信部专精特新“小巨人”认定、广东省智能制造试点示范企业、广东省战略性新兴产业骨干（培育）企业、广东省著名商标认定、ISO9001 质量体系认证、市区两级首台套重大技术装备奖励、深圳市战略性新兴产业资金专项扶持、宝安区创新百强企业、宝安区龙头企业、科学技术奖等资质荣誉，在产业研发和生产上具有较强的市场竞争力。

（2）公司拥有完善的管理体系和充足的人才储备

公司始终坚持让客户满意的理念，持续完善生产技术，制造一流产品；提供优质专业服务，通过持续改进和完善，建立了严格的质量标准和管理体系。为确保自动化设备的安全、稳定、精确运行，公司严格按照 ISO9001:2015 标准制定了一系列质量控制文件，并建立了以品质部为质量控制执行核心，市场中心、研发中心、制造中心等部门协助配合，全面覆盖原材料采购过程、生产装配过程、整机调试过程的全流程质量控制体系，保证了产品质量，赢得了客户的认可和信赖。公司始终重视人才队伍的建设和培养，建立了一套完善的“引、育、用、留”体系。经过多年的发展，公司形成了一支由研发技术人员、销售服务人员及核心

管理人员组成的高度稳定的人才队伍。人员队伍涵盖机械、电气、软件、视觉、工艺、组装等不同技术领域的人才。公司拥有完善的管理体系和充足的人才储备为本项目实施奠定了基础。

(3) 公司拥有优质的客户群体

公司致力于成为业界一流的智能制造装备企业，始终坚持以客户需求为中心，以客户满意度为宗旨，致力于更高、更快、更优地满足客户对产品的需求。经过多年的发展，公司在产品研发、生产、销售、管理等方面都积累了丰富的行业经验，凭借日益精进的研发水平、领先的生产技术工艺、完善的销售服务、卓越的产品质量，在半导体封装测试设备领域，与扬杰科技、华天科技、通富微电、山东晶导微电子股份有限公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司等企业建立了合作关系，累计积累了众多优质客户群体。

5、项目实施主体与投资情况

本项目实施主体为公司全资子公司惠州深科达智能装备有限公司，项目建设地点位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村。本项目拟投资 12,521.87 万元，其中场地建设投资 3,545.43 万元，设备及软件投资 5,380.16 万元，预备费 596.28 万元，铺底流动资金 3,000.00 万元，具体情况如下：

序号	项目	投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	场地投资	3,545.43	3,545.43
1.1	场地建设费	1,595.44	1,595.44
1.2	场地装修费	1,949.99	1,949.99
2	设备及软件投资	5,380.16	5,380.16
3	预备费	596.28	-
4	铺底流动资金	3,000.00	-
	合计	12,521.87	8,925.59

6、项目预计实施时间、整体进度安排

本项目建设期为 2 年，项目进度计划内容包括工程设计及准备工作、场地建设及装修、设备购买及安装调试、新员工招聘培训、试生产及验收等。具体进度如下表所示：

项目实施内容	T1				T2			
	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12

工程设计及准备工作								
场地建设及装修								
设备购买及安装调试								
新员工招聘培训								
试生产及验收								

7、项目经济效益分析

经测算，本项目税后的内部收益率为 18.17%，税后投资回收期为 6.42 年。

（三）平板显示器件自动化专业设备生产建设项目

“平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”系首次公开发行股票并上市时尚未募足所需投资总额的募集资金投资项目，根据整体建设进度计划，该项目本次发行拟使用募集资金金额系截至本次发行董事会召开日尚未投资建设的一部分。

本项目拟使用本次募集资金金额情况，具体如下：

单位：万元

项目名称	总投资金额	拟使用首次公开发行股票并上市募集资金金额	扣除首次公开发行股票并上市募集资金后的投资金额	拟使用本次募集资金金额
平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	25,807.94	20,462.86	5,307.94	5,307.91

本项目将建设现代化的平板显示器件自动化专业设备产业化生产基地，通过新建厂房及附属设施，购置先进的生产设备，吸引行业内优秀人才，扩大公司生产规模，提高产品质量和生产效率。通过项目的实施，公司将建设国内领先的平板显示器件自动化专业设备生产基地，以满足日益发展的平板显示行业对设备的需求，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

本项目的实施背景、实施必要性、实施的可行性、实施主体与投资情况、经济效益分析等具体情况可参见《深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

截至本预案公告日，本项目尚处于实施过程中。

（四）补充流动资金

1、项目概况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等因素，计划将本次募集资金中的 10,000 万元用于补充流动资金。

2、补充流动资金的必要性和合理性

（1）公司经营规模逐步扩大，经营性流动资金需求日益增加

近年来，公司生产经营规模逐步扩大的同时，存货和应收账款占用的资金规模也在增长，导致公司对流动资金的需求持续上升。2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月末，公司存货账面价值分别为 15,731.47 万元、15,644.57 万元、24,674.74 万元和 29,461.23 万元，应收账款账面价值分别为 20,607.52 万元、27,425.90 万元、39,422.69 万元和 54,799.75 万元。使用部分募集资金补充流动资金可以满足公司日常经营中营运资金的需求，有利于公司持续健康发展。

（2）满足持续研发投入的需求

公司始终坚持以技术研发和产品创新为业务发展的核心驱动力，一直注重技术研发，每年均投入大量的人力、资金用于技术升级和新产品开发。截至 2021 年 9 月 30 日，公司有 251 名研发人员，2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月，公司研发费用分别为 4,308.14 万元、4,762.40 万元、6,076.95 万元和 5,319.34 万元，随着公司在平板显示器件生产设备领域持续加大技术研发力度，公司的研发队伍和研发投入将进一步扩大，研发资金需求将进一步增长。

（3）满足公司发展战略，增强综合竞争力的需要

充足的营运资金作为公司业务发展的基础，是抵御市场竞争风险、应对市场变化、实现公司战略的需要，也是公司综合竞争实力的体现。募集资金到位后，公司的资金实力得到增强，可以更好地保证生产经营的顺利开展，提升公司的对外扩张实力，提高市场占有率和抗风险能力。

3、补充流动资金的管理运营安排

公司将严格执行上海证券交易所、中国证监会有关募集资金使用的规定，并

按照《募集资金管理制度》对补充流动资金进行管理。公司实行募集资金的专户存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户中。募集资金到账后，公司将根据实际经营需求合理安排补充流动资金的使用，以保障募集资金的安全和高效使用。在具体资金使用过程中，公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限来实施，以确保资金使用规范、透明、公开。

三、募集资金投资项目涉及报批事项情况

截至本预案公告日，公司“惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”和“半导体先进封装测试设备研发及生产项目”的备案和环评报批手续正在办理中。

公司“平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”的备案和环评报批手续已经办理完毕。

公司“补充流动资金”项目无需履行备案和环评报批手续。

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

公司本次项目资金的运用是以现有主营业务为基础，结合未来市场需求，提升公司产品生产能力的重要战略举措。项目建设完成后将进一步丰富公司产品线，提高产品交付能力，扩大经营规模和盈利能力；从而进一步提升公司在行业内的市场地位和核心竞争力，为公司的可持续发展和战略目标的实现提供可靠的保证。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

项目资金到位后，公司净资产及每股净资产将大幅提高，这将进一步优化公司财务状况，提高公司的整体竞争力。项目资金到位后，短期内公司的净资产收益率将可能因净资产增加而有所下降，但随着新建项目效益的逐渐显现，预计公司的营业收入和营业利润将大幅增长，盈利能力不断提高，净资产收益率将逐步

回升。

总体来看，本次发行有利于增强公司的整体实力，改善公司的财务状况和经营业绩，提升公司的竞争优势与盈利能力。

五、可行性分析结论

经审慎分析，董事会认为：公司本次发行可转债募集资金是紧抓行业发展机遇，加强和扩大竞争优势，实现公司战略发展目标的重要举措。公司本次募集资金投向将紧密围绕科技创新领域与公司主营业务开展，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。通过本次募投项目的实施，公司将进一步扩大业务规模，增强公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。综上所述，本次募集资金投资项目具有较强的可行性。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2022年4月13日